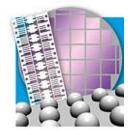
# 

## 专为半导体电子开发的碱性除助焊剂清洗剂



HYDRON® SE 230A 是专为浸没式清洗工艺设计的单相水基清洗剂。该产品能够有效去除多种半导体电子器件在芯片焊接后的助焊剂残留物,包括引线框架、分立器件、功率模块、功率 LED、倒装芯片和 CMOS。本产品能够为引线键合及封装等后续工艺提供卓越的去氧化的铜基材表面。

应用领域: 半导体电子器件的除助焊剂 (引线框架、分立器件、功率模块和功率 LED、倒装芯片、CMOS)			本产品的更多信息:
	低固型	+	
	水溶性(OA)	++	
锡膏类型	免洗型	++	技术信息 3: 材料兼容性概览
	高固型	++	
	有铅	+	

- ++ 强烈推荐,效果最佳 +
- 荐 0 可能
- J能 不推荐
- \* 对所有标准的、无铅与含铅的焊锡膏均适用

# ZESTRON 技术中心: ① 美洲 ② 欧洲 ③ 马来西亚 ④ 上海-中国 ⑤ 深圳-中国 在生产条件下提供清洗工艺解决方案











关于免费清洗试验,请咨询 ZESTRON 应用技术中心: 电话: +86-21-5296-8185; Email: infochina@zestron.com

### 优点(与其他清洗液相比):

- HYDRON® SE 230A 能够为后续的引线键合、封装及胶粘等工艺提供无污点的铜表面且能够确保激活的铜表面在一定时间内保持活性。
- HYDRON® SE 230A 在处理铜、铝,特别是镍等敏感材料时确保了极佳的材料兼容性。
- 由于其表面张力较低,该产品在清洗低间隙元器件的底部残留物时拥有卓越表现。
- HYDRON® SE 230A 是一种单相清洗剂,应用过程十分简单且在浸没式清洗工艺中提供卓越的清洗结果。
- 本产品易被去离子水漂洗干净,不会留下任何残留物。
- HYDRON® SE230A 没有闪点,其配方中不含任何卤素成分且气味很淡。

PR00740169.DOC release date: 29.07.2016

工艺步骤	1. 清 洗	2. 漂 洗	3. 干燥
超声波 / 底部喷流	HYDRON® SE 230A	去离子水 ¹	热风或循环风烘干

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>去离子水的温度应当保持在 20-40°C/68-104°F。

<b>技术参数</b> 请注意:本表中列出的数据,采集自浓度为 15%的 HYDRON® SE 230A						
密度	(g/ccm) 在 20° C/68° F时	0.99				
表面张力	(mN/m) 在 25° C/77° F时	27. 7				
沸程	° C/° F	>98℃ / >208℉				
闪点	° C/° F	无闪点,直至沸点				
pH 值	10g/I H <sub>2</sub> O	9,60				
蒸气压	(mbar) 在 20° C/68° F 时	约为 20				
应用温度	° C/° F	40 – 60°C / 104 – 140°F				
水溶性		可溶的				
应用浓度 1	浓度	15-25%				

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>使用 HYDRON® SE 230A 时,必须用去离子水稀释。

#### 产品特点



经过广泛测试,本产品适用于去除 无铅焊锡膏的残留物



本产品不含有 SIN 和 SVHC 清单中 列出的任何危险物质



本产品完全符合欧盟的各项法规 (RoHS 1&2, WEEE)

### 过滤系统建议:

为了完全发挥该清洗剂的功能并进一步延长 HYDRON® SE 230A 的使用寿命, ZESTRON 推荐使用循环过滤系统。

#### 环保、健康及安全法规:

- HYDRON® SE 230A 是可以生物降解的水基清洗剂。
- 该产品不含卤素成分,安全环保。
- 请参阅 MSDS 以了解关于该产品的使用须知和注意事项。

#### 包装/储存:

- 本产品提供浓缩液包装,包括1升瓶装,5升或25升罐装及200升桶装。
- 建议将本产品储存于 5 30° C / 41 86° F 温度环境下的原始包装中。
- 在工厂密封包装的条件下,本产品的有效期至少为5年。

infojapan@zestron.com 神奈川县 - 日本

infochina@zestron.com 上海/深圳-中国

infoasia@zestron.com

infousa@zestron.com

PR00740169.DOC release date: 29.07.2016